

## 日月光一〇二年度第三季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 102 年 10 月 30 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇二年度第三季獲利報告，本公司一〇二年度第三季之合併營業收入較一〇二年度第二季成長 12%，較一〇一年同期成長 16%，為新台幣 56,748 百萬元。茲將日月光一〇二年度第三季單季及前三季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

簡明日月光集團合併營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	102 年度 第三季	102 年度 第二季	101 年度 第三季	102 年度 前三季	101 年度 前三季
營業收入	56,748	50,760	48,991	155,698	137,964
營業毛利	11,587	10,436	9,612	30,304	25,644
營業淨利(淨損)	6,099	5,403	4,795	15,105	11,753
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	5,368	5,038	4,464	13,565	10,769
所得稅利益(費用)	(822)	(1,127)	(866)	(2,752)	(1,773)
非控制權益純損(益)	(116)	(91)	(147)	(332)	(303)
本期歸屬予母公司股東淨利(淨損)	4,430	3,820	3,451	10,481	8,693
稀釋每股盈餘(元)	0.57	0.50	0.46	1.36	1.14

簡明日月光半導體封裝測試營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	102 年度 第三季	102 年度 第二季	101 年度 第三季	102 年度 前三季	101 年度 前三季
營業收入	37,810	36,295	33,891	105,422	95,612
營業毛利	9,646	8,723	7,708	24,593	20,578
營業淨利(淨損)	5,383	4,810	3,992	12,862	10,001
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	5,134	4,833	4,204	12,743	10,150
所得稅利益(費用)	(661)	(975)	(704)	(2,142)	(1,370)
非控制權益純損(益)	(43)	(38)	(49)	(120)	(87)
本期歸屬予母公司股東淨利(淨損)	4,430	3,820	3,451	10,481	8,693
稀釋每股盈餘(元)	0.57	0.50	0.46	1.36	1.14

### 半導體封裝測試營運

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	55
個人電腦	11
汽車及消費性電子產品	34
其他	0
前十大客戶佔營收比重	49

銷 售 地 區	占營收比率(%)
北美	60
歐洲	10
台灣	17
日本	7
亞洲其他地區	6

封 裝 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
Advanced Packaging	28
IC Wirebonding	61
Discrete and Others	11
封裝資本支出金額	157 百萬美元
打線機台數	15,765 台

測 試 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
後段測試	77
晶圓測試	20
前段測試	3
測試資本支出金額	50 百萬美元
測試機台數	3,147 台

### 電子製造代工服務之產品結構及客戶組成

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	47
電腦產品	20
消費產品	13
工業產品	12
汽車電子產品	7
其他	1
前十大客戶佔營收比重	86
EMS 資本支出金額	16 百萬美元

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2013 年第四季的業績展望如下：

- 半導體封裝測試材料營收將小幅下滑約 0% 至 3%，電子製造代工服務營收將成長超過 25%；
- 合併營業毛利率預計介於 18% 到 19% 之間；
- 全年在設備方面的資本支出約美金 7 億元，並根據市場狀況調整。